



京セラ株式会社 2023年3月期 通期 決算説明会

(2023年5月16日開催)

代表取締役社長 谷本 秀夫 スピーチ

<1. 目次>

<2. (中表紙) 2023年3月期 実績>

<3. 2023年3月期 通期実績(1)>

当期の売上高は前期に比べ10.1%増加の2兆253億円となり、2期連続で過去最高を更新するとともに、これまで目標として掲げてきた2兆円を達成することができました。

スマートフォン向け部品の需要減の影響は受けたものの、高水準の需要が継続した先端半導体向け部品の増産に加え、ドキュメントソリューション事業及び機械工具事業等での販売増加や円安の効果もあり、増収となりました。

一方、利益については、増収及び円安の効果はあったものの減少し、税引前利益は1,762億円となりました。インフレに伴う原価上昇、及びコミュニケーション事業の大幅な売上減少に加え、訴訟関連費用や構造改革費用等の一時的な費用 約190億円を計上したこともあり、減益となりました。

<4. 2023年3月期 通期実績(2)>

設備投資額は1,739億円、有形固定資産減価償却費は1,088億円、研究開発費は943億円となりました。半導体関連市場向け部品の増産対応や既存事業の強化、並びに新規事業開発に積極的に取り組んだことを主因として、それぞれ前期に比べ増加しました。

<5. 2023年3月期 事業セグメント別売上高>

事業セグメント別売上高の一覧です。

<6. 2023年3月期 事業セグメント別利益>

事業セグメント別利益の一覧です。

続いて各事業セグメントの売上、利益の詳細についてご説明します。

<7. (コアコンポーネント) 2023年3月期 事業セグメント別業績>

「コアコンポーネント」の売上高は5,924億円となりました。半導体関連部品事業における、情報通信インフラ市場向けの有機基板の需要や、産業・車載用部品事業における、半導体製造装置用ファインセラミック部品等の高付加価値製品の売上が増加したことにより、増収と

なりました。

利益は895億円となりました。増収に加え円安効果もあり、利益率は15.1%へ向上しました。

<8. (電子部品) 2023年3月期 事業セグメント別業績>

「電子部品」の売上高は3,785億円となりました。産業機器市場や自動車関連市場向けを中心に、セラミックコンデンサ等の需要が増加したことに加え、円安効果もあり、増収となりました。

利益は441億円となりました。原材料等の価格高騰の影響や、スマートフォン向け部品の需要が減速したことに加え、KYOCERA AVX Components Corporation (以下、KAVX)において年金債務に係る追加費用等、約30億円を計上したこともあり、減少しました。

<9. (ソリューション) 2023年3月期 事業セグメント別業績>

「ソリューション」の売上高は1兆686億円となりました。ドキュメントソリューション事業及び機械工具事業において、主要製品の販売が増加したことに加え、円安効果もあり、増収となりました。

利益は422億円となりました。コミュニケーション事業における携帯電話端末の販売台数の大幅な減少に加え、構造改革に伴う在庫の評価減等、約80億円の計上や、原材料及びエネルギー価格、物流コスト等の高騰の影響を受けたことから、減少しました。

以上が当期の決算概要です。続いて、2024年3月期業績予想についてご説明します。

<10. (中表紙) 2024年3月期 業績予想>

<11. 2024年3月期 業績予想(1)>

今期は、引き続き不安定な世界情勢や経済環境が懸念されるものの、当社の主要市場における需要の回復が徐々に進むものと見込んでいることから、前期に比べ増収増益の売上高2兆1,000億円、税引前利益2,000億円の予想としています。

なお、業績予想の前提為替レートは、対米ドルは125円、対ユーロは130円を予想しています。

<12. 2024年3月期 業績予想(2)>

設備投資額は2,750億円、有形固定資産減価償却費は1,230億円、研究開発費は1,150億円を見込んでおり、成長に向けた積極的な投資を予定していることから、それぞれ大幅に増加する計画です。特に設備投資については、「コアコンポーネント」における、半導体関連市場向け部品の増産対応を中心に、前期比58.1%の増加を見込んでいます。

<13. 2024年3月期 事業セグメント別売上高予想>

事業セグメント別の売上高は、「コアコンポーネント」は6,200億円、「電子部品」は3,900億円、「ソリューション」は1兆1,150億円とし、全セグメントでの増収を見込んでいます。

<14. 2024年3月期 事業セグメント別利益予想>

事業セグメント別の利益は、「コアコンポーネント」は860億円と微減の見通しですが、「電子部品」は550億円、「ソリューション」は790億円と、大幅増益を見込んでいます。

<15. 2024年3月期 業績予想サマリー>

今期業績予想のサマリーについてご説明します。

左側の売上高は、「コアコンポーネント」及び「電子部品」は当面、半導体関連市場をはじめとする当社主要市場の調整が続くものの、上期後半以降は緩やかな回復を見込んでいます。また、「ソリューション」においては、ドキュメントソリューション事業を中心とした新製品及び新事業の積極的な展開による売上増を見込んでいます。

右側の利益は、「コアコンポーネント」は、投資が先行していることから微減となる見通しです。「電子部品」は、前期に一時費用を計上していましたが、この影響がなくなることに加え、コンデンサ等の高採算部品の市況回復を見込んでいることから増益を予想しています。「ソリューション」は、増収に加え、構造改革に伴う収益性の向上もあり、利益は大幅に改善する見通しです。なお、「その他の事業」は、新規事業の創出に向けた研究開発費の増加等が影響する見通しです。

以上が、今期業績予想の概要です。続いて、中期経営計画についてご説明します。

<16. (中表紙) 中期経営計画>

<17. (全体概要) 中期経営計画における基本的な考え方>

当社中期経営計画における基本的な考え方についてご説明します。

1つ目は経営理念の実現です。「全従業員のもの心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること。」この経営理念は、当社の存在意義そのものといえます。

2つ目は高収益経営の実践です。経営をシンプルにとらえ、日々創意工夫をこらしながら粘り強く、売上最大、経費最小を目指し続けることが持続的成長を続けるために非常に重要なことです。

これら2つは当社にとって不変の考え方であり、中期経営計画の立案に際し、改めて経営の原点に立ち返りたいと考えております。

<18. (全体概要) 経営環境・社会情勢>

当社を取り巻く経営環境や社会情勢についてご説明します。

左側は「半導体市場の中長期的な拡大」です。2022年から2030年の8年間で半導体市場の

規模は2倍の100兆円規模になることが見込まれています。

中央は「AI、5G、ADASなど新技術の社会実装本格化」です。急速なデジタル技術進化により私たちの生活そのものが変わることが予想されます。

右側は、「世界的な環境意識の高まり」です。利便性が高まり、生活が豊かになる一方で、地球温暖化など世界規模での社会課題解決が求められています。

これらの中長期的な環境・社会の変化に対し、当社はそれぞれの貢献領域を定め、保有する技術や関連製品の供給を通じて、人類・社会が直面する諸課題の解決を図ってまいります。その結果として高成長・高収益経営を実現していきたいと考えております。

<19. (全体概要) 成長のステージ>

当社は、2001年3月期の売上高1兆円達成から22年かけて、2023年3月期に、売上高2兆円を達成しました。そして、新たな成長のステージに乗せることで、次の目標である売上高3兆円、利益率20%を6年間で達成したいと考えています。

今回、その前半3年間の中期経営計画を策定し、中期目標として売上高2.5兆円、利益率14%を設定しました。高い目標を設定し、成長軌道へと回帰させることで、京セラグループ全体にチャレンジ精神を取り戻したいと考えています。

<20. (全体概要) 注力分野における積極投資>

中期経営計画の達成に向け、最も重要になるのが注力分野における積極投資です。

スライドの棒グラフは、設備投資額と研究開発費の推移を2018年3月期からの3年間、2021年3月期からの3年間、今回の中期経営計画の期間となる2024年3月期からの3年間の、各合計の順に示しています。過去3年間合計でそれぞれ5,169億円、6,967億円であった投資を、次の3年間では最大1兆2,000億円まで引き上げる計画です。

また、右上に設備投資の内訳を円グラフで示しています。赤色で示す半導体関連部品の「コアコンポーネント」、緑色で示すコンデンサ・タイミングデバイス等の「電子部品」、合わせて7割以上は部品事業への設備投資となる計画です。

研究開発投資は売上高の5%を目安としています。既存事業進化のための技術開発、及び社会課題解決型の新事業創出を進めており、設備投資と合わせて高成長が見込まれる市場や製品向けに集中投資を行ってまいります。

<21. (全体概要) 数値目標 (京セラグループ連結)>

中期経営計画の主な数値目標です。

一番右の列、2026年3月期に、売上高2.5兆円、税引前利益3,500億円、利益率14.0%、ROE 7.0%以上の中期目標を掲げ、それを実現すべく2024年3月期からの3年間合計で、最大8,500億円の設備投資、3,500億円の研究開発費を計画しています。この計画達成に向け、京セラグループの総力を結集してまいります。

<22. (全体概要) 業績目標達成に向けた経営戦略>

中期業績目標達成に向けた経営戦略についてご説明します。

上段、京セラグループ全体共通の経営戦略として、

1. 過去最大規模の積極投資を継続的に実施、
2. 競争優位領域への社内資源結集による高成長の実現、
3. デジタル技術を最大限活用した収益性の向上、
4. 事業継続、撤退の判断の迅速化による経営資源の最適配分の4つを掲げています。

事業セグメント別では、「コアコンポーネント」は、高成長が期待される半導体関連市場へ注力し、増産と生産性向上のため積極的な設備投資を実行します。

「電子部品」は、グループ会社のKAVXとのシナジーを最大化し、シェア拡大を図るべく、コンデンサとタイミングデバイスへ注力してまいります。

「ソリューション」は、環境配慮型製品と社会課題解決型事業を拡大するとともに、コミュニケーション事業、エネルギー事業の構造改革による収益改善を図ります。

<23. (全体概要) セグメント別中期目標 (2026年3月期)>

事業セグメント別の中期業績目標です。

2026年3月期には、「コアコンポーネント」は売上高7,800億円、事業利益1,404億円、利益率18.0%、「電子部品」は売上高5,000億円、事業利益1,000億円、利益率20.0%、「ソリューション」は売上高1兆2,500億円、事業利益1,250億円、利益率10.0%の達成を目指します。

続いて、各セグメント個別の事業戦略についてご説明します。

<24. (中表紙) 中期経営計画 事業戦略>

<25. (コアコンポーネント) 事業環境>

「コアコンポーネント」の事業環境についてご説明します。

左側は市場環境です。上段の半導体市場は、足元では在庫調整の局面にあるものの、ロジックでCAGR 11%、メモリーで5%と、中長期的には最先端品を中心に大幅な需要増を見込んでいます。下段の半導体製造装置は、半導体の世代進化に伴い製造工程が増え、2030年の装置需要は2022年比較で、露光装置、コーター・デベロッパが約2倍、エッチング・成膜装置が約2.5倍と、大幅拡大が見込まれています。

右側の上段は当社の主要製品です。半導体関連市場に対し、ネットワークサーバ用有機パッケージ、半導体用セラミックパッケージ、半導体製造装置用ファインセラミック部品を供給しています。右側の下段は当社の強みです。パッケージ製品では大型化、高多層化に対応する製造技術と戦略顧客における高いシェア、半導体製造装置用ファインセラミック部品では精密加工や温度均一性など先端品の技術・品質・生産対応力と先進装置メーカーとの長年にわたる強固な信頼関係という強みを活かすことで、先端半導体を中心に顧客要求へ迅速かつ的確に対応し、高い市場シェアを維持・拡大してまいります。

<26. (コアコンポーネント) 事業戦略>

左側のグラフは「コアコンポーネント」の事業別売上、事業利益、及び利益率の2026年3月期中期目標を示しています。この計画を達成すべく、中長期的な市場拡大を当社の事業成長に着実に結びつけ、競争優位分野で事業を飛躍的に伸ばしていきます。

具体的には2026年3月期に、半導体関連部品事業は情報通信向け有機基板の増産対応を中心に売上高4,900億円、産業・車載用部品事業は最先端半導体製造装置用ファインセラミック部品の増産対応を中心に売上高2,550億円まで伸ばす計画です。

<27. (コアコンポーネント) 投資戦略>

「コアコンポーネント」の投資戦略についてご説明します。

左側の基本方針は、増産に向けた投資の加速です。顧客との密な連携に基づく更なる先行投資の強化、及び建築資材調達や工期の長期化を考慮した新工場、新棟建設の早期対応を行うため、直近の3年間合計の1,726億円から次の3年間では2.3倍の4,000億円まで増やす計画です。

右側は主な設備投資です。写真で示しています長期的需要増を見据えた新棟の立ち上げに加え、既存工場のスクラップ&ビルドを実施することで主要製品の生産容量を拡大します。具体的には、この設備投資により半導体有機材料関連で現状の2.4倍、ファインセラミック関連で1.8倍、半導体セラミック材料関連で1.4倍の増産効果を見込んでいます。

以上のように中長期的な需要拡大への対応準備を行うべく、過去最大規模の積極的な設備投資を実施してまいります。

<28. (コアコンポーネント) 新工場建設>

既存工場だけでは今後更に増加する半導体市場の需要への対応が困難であることから、当社としては約20年振りとなる国内工場新設のため、長崎県諫早市に工場用地を取得いたしました。

こちらのスライドは、2023年4月に発表しました新工場建設の概要です。

生産品目は、半導体製造装置用ファインセラミック部品や半導体パッケージなどを予定しており、2027年3月期より生産を開始し、2029年3月期には年間生産250億円を計画しています。

以上が「コアコンポーネント」の説明です。続いて、「電子部品」についてご説明します。

<29. (電子部品) 事業環境>

左側に示しています電子部品の市場は、エレクトロニクス産業の進展に伴い更なる拡大が予想されます。具体的には、コネクタがCAGR 4%、積層セラミックコンデンサが10%、タイミングデバイスが5%、ポリマータンタルが7%拡大する見通しです。

右側の上段は「電子部品」の主要製品です。左からタンタルコンデンサ、タイミングデバイス、積層セラミックコンデンサ、コネクタです。

下段の当社の強みは、IC の高集積化に貢献する小型・高精度化技術や、産業機器から車載、医療、航空宇宙まで幅広い KAVX のディストリビューター販売チャネルと物流ネットワークです。タンタルコンデンサやタイミングデバイスで高シェアを維持する一方、積層セラミックコンデンサやコネクタは市場シェア向上を目指しています。

このように、独自技術の確立とその技術が生きる競争優位分野へ注力することにより、市場シェアの拡大を図ってまいります。

<30. (電子部品) 事業戦略>

左側のグラフは「電子部品」の売上、事業利益、及び利益率の 2026 年 3 月期中期目標を示しています。この計画を達成すべく、得意分野に注力し、京セラと KAVX のシナジーを発揮することで市場シェア拡大と収益性向上を図ります。

具体的には、販売面では KAVX のグローバルな販売網や有力顧客との強固な関係性を京セラ電子部品の製品拡販につなげます。その一方、製造面では京セラ電子部品の省人化・効率化を追求した生産技術を KAVX の生産拠点に導入することで、生産性の向上につなげます。これらシナジー効果を発揮することで、市場シェアをタンタルコンデンサは 30%から 40%、タイミングデバイスは 10%から 20%、積層セラミックコンデンサは 5%から 10%、コネクタは 2%から 5%へ向上させるという目標を設定しています。

以上のように、京セラ電子部品と KAVX のシナジー発揮によりシェアを上げ、市場成長率を上回る成長を実現してまいります。

<31. (電子部品) 投資戦略>

「電子部品」においても、京セラ電子部品と KAVX の生産拠点最適化のため、積極的な投資を行う計画です。今後の生産能力拡大に向けたグローバル生産体制の構築と自動化・省人化に不可欠なデジタル技術の積極採用により、3 年間合計で 2,100 億円の設備投資を計画しています。

主な設備投資は右側の通りです。タイでの新工場建設や鹿児島国分工場での新棟建設に加え、既存の KAVX 拠点への自動化ライン導入を推進することで、主要製品の生産容量の拡大を図ります。具体的にはこの設備投資により、積層セラミックコンデンサで現状の 1.9 倍、タイミングデバイスで 1.8 倍、タンタルコンデンサで 1.4 倍の増産効果を見込んでおり、増産体制構築とグローバル拠点最適化に向けた設備投資、並びに生産性改善のための DX を推進してまいります。

以上が「電子部品」の説明です。次に「ソリューション」についてご説明します。

<32. (ソリューション) 事業戦略>

左側のグラフは「ソリューション」の事業別売上、事業利益、及び利益率の 2026 年 3 月期中期目標を示しています。この数値目標を達成するための事業戦略を右側に示します。

1 つ目は既存事業の拡大で、主要事業は機械工具事業と情報機器事業です。2 つ目は構造改革

の推進で、対象事業は通信機器事業とエネルギー事業となります。「ソリューション」は多岐にわたる事業体であるため、市場性と収益性の両面から各事業の見極めを行い、将来の成長分野へリソースを集中・統合してまいります。

続いて、各事業の個別戦略についてご説明します。

<33. (ソリューション) 機械工具事業>

機械工具事業についてご説明します。

当事業においては、切削工具市場は、2025年には2022年比で約1.2倍、空圧・電動工具は約1.15倍と、ともに市場成長が期待されています。この環境の下、当社は、2026年3月期には売上高3,500億円、事業利益420億円、利益率12.0%まで成長させる計画です。

右側に重点施策を示しています。切削工具では、欧州・アジアでの販売強化、付加価値の高い特注工具や新工法の開発力を活かした成長産業向け製品開発、DX付加価値サービスの推進に注力します。空圧・電動工具では、開発、製造、販売、サービスまで一貫体制の強みを活かしたグローバルシェアの拡大と、充電プラットフォームの共通化など、セグメント内技術連携による付加価値創出に取り組めます。引き続き積極的な投資を継続し、グローバル総合工具メーカーとして事業拡大を図ってまいります。

<34. (ソリューション) ドキュメントソリューション事業>

ドキュメントソリューション事業についてご説明します。

左側の上段に示す通り、オフィスでのペーパーレス化が進み、MFPやプリンターの市場は2025年に2022年比で約0.95倍と縮小する一方、商業用インクジェットは約1.25倍、ECMは約1.15倍に伸長することが予想されます。この環境の下、当社は、2026年3月期には売上高5,000億円、事業利益530億円、利益率10.6%まで成長させる計画です。

右側に重点施策を示しています。MFP・プリンターでは、長寿命設計の強みを活かした環境に優しい新製品の積極投入によるシェア拡大と、ベトナムでの生産拡大による収益性改善に取り組めます。商業用インクジェットでは、多種多様な用紙への印刷が可能な新製品を投入することで、売上と利益の拡大を図ります。ECM・ドキュメントBPOサービスでは、自社製ECMソフトウェアのラインアップ拡充とグローバル展開を図ります。ドキュメントソリューション事業の強みでもある、環境に優しい製品とソリューションの組み合わせで、持続可能な社会実現に貢献していきたいと考えています。

<35. (ソリューション) コミュニケーション事業 — 構造改革 —>

コミュニケーション事業の構造改革についてご説明します。

改革テーマは、左側の上段に示す事業構造の抜本的転換で、商品・カテゴリーの選択と集中、及び法人向けソリューション事業への注力を進めてまいります。構造改革を進めることにより、2024年3月期には黒字化、2026年3月期には7%の利益率とする計画です。

右側に主な構造改革の内容を示します。赤枠のコンシューマー向けスマートフォン事業は、

2023年3月期の新規開発完了、2025年3月期の供給・販売の終了をもって終息させる計画です。そして、今後日本国内でも社会実装が期待されるミリ波5G通信の更なる普及に向けたインフラ関連事業へ開発リソースを集中します。

一方、青粋の端末開発に関しては、収益性の高い法人向けカスタム機器とそれに付随する通信サービスの提供にシフトするとともに、京セラコミュニケーションシステム株式会社の主力事業であるICTサービス、エンジニアリング事業を拡大してまいります。

以上、法人向け通信ソリューション事業とインフラ関連事業へ転換することで、コミュニケーション事業の収益性を高める計画です。

<36. (ソリューション) エネルギー事業 — 構造改革 —>

エネルギー事業の構造改革についてご説明します。

改革テーマは、再エネ需要とエネルギー価格高騰に対応する法人向け電力販売サービスの拡大です。まずは当社が持つ太陽電池、蓄電池、SOFC燃料電池の3つの電池の生産性倍増と原価低減を図り、下段のグラフに示す通り、2024年3月期には黒字化する計画です。同時に、従来のモノ売りから余剰電力の買い取りと再販を行う再エネ電力販売事業のコト売りへ転換を図ることで、2026年3月期には5%の利益率を目指します。

右側は、当社が目指す再エネ電力サービスのビジネスモデルです。今後、当社は住宅や企業、大規模な太陽光発電所の余剰電力を買い取り、再エネ電力の需給調整やマッチングを行い、この再エネ電力を自社で活用することで、京セラグループ全体の再エネ比率を向上させると同時に、環境経営企業等の外部へも積極的に展開していく計画です。環境対応は人類・社会が直面する最重要課題ですので、大義を持って取り組んでいきたいと考えています。

<37. (ソリューション) エネルギー事業 — パートナー連携 —>

再エネ電力サービスを実現するには、パートナー連携が不可欠となります。左側は大東建託株式会社様との電力買取契約締結の例です。2023年4月より、大東建託株式会社様のネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、ZEH賃貸集合住宅で発電した電力を当社が買い取り、当社工場での利用を開始しています。

右側は、auリニューアブルエナジー株式会社様との再生可能エネルギー発電事業の推進に向けた資本業務提携の例です。発電した電力をKDDI株式会社様保有の基地局・通信局舎・データセンターの施設で利用するだけでなく、昼間の余剰電力を大型の蓄電池に充電し、需給調整市場などへの売電も進める計画です。

以上が「ソリューション」の説明です。

<38. (新事業創出) 社会課題解決型事業の拡大>

新事業創出についてご説明します。当社は社会課題解決型の事業を拡大すべく、積極的な研究開発投資を行っています。いくつか進行中のプロジェクトをご紹介します。

左端は窒化ガリウムを使った高効率GaNレーザーです。子会社のKYOCERA SLD Laser社が保

有する、照度・輝度と安全性を両立する独自の LaserLight 技術の用途拡大や製品ラインアップ拡大を図り、低炭素社会の実現に貢献します。

右隣のデジタル捺染システムは、ウォーターフリーを実現する独自のプリントヘッド技術とインク技術の強みを活かし、アパレル産業における排水・廃棄の抑制に貢献します。

その右隣の当社が開発する協働ロボットは、ロボットへの作業指示を容易にする AI 制御技術と、自社工場を多く持つ製造業ならではの豊富な製造用学習データが強みであり、自社利用も含め人員不足の解消に貢献します。

右端は路車協調システムです。死角にある情報を検知する ITS 無線路側機と遠赤外線カメラ技術を活用し、無事故で安心・安全な街づくりに貢献します。

具体的な事業目標としては、1 プロジェクト当たりの将来売上高 1,000 億円規模を目指しており、積極的な研究開発投資を行ってまいります。

<39. (中表紙) 中期経営計画 経営基盤の強化>

<40. (経営基盤の強化) 事業成長を支える資本戦略>

経営基盤の強化についてご説明します。

まずは事業成長を支える資本戦略についてですが、中期経営計画に基づき、2024 年 3 月期から 2026 年 3 月期までの 3 年間のキャピタル・アロケーションを明確化しました。中央の図を用いて、順に説明します。

①の営業活動によるキャッシュ・フローは、研究開発費控除前のベースで 1 兆 4,000 億円～1 兆 5,000 億円と試算しています。また、②に示すように、今後の積極的な投資活動や株主還元維持・向上などの資金需要に応じて、最大 5,000 億円の銀行借入を行う考えです。また、借入に際しては、将来的な金利上昇の可能性も考慮し、KDDI 株式を担保とすることにより、借入コストを低減します。

図の右側の③と④は、先ほどご説明しました積極投資を、⑤は次の 3 年間も配当水準を維持すべく、約 3,000 億円の配当金を計画しています。また⑥として、シナジーを重視した M&A の検討に加え、適宜自社株買いを行う方針の下、4,000 億円～5,000 億円の充当を考えています。

<41. (経営基盤の強化) 株主還元策>

株主還元策についてご説明します。

当社の株主還元は、配当性向 50%程度を目安とする配当金と、自社株買いを適宜実施することを基本方針としており、2023 年 3 月期の年間配当金は、1 株当たり 200 円とさせていただきます。また、2024 年 3 月期の年間配当金は 200 円を予想しており、2023 年 5 月 15 日に上限 500 億円の自社株買いの実施について発表しました。今後も継続して、安定的な配当と自社株買いの適宜実施を行い、業績向上を通じてさらなる株主還元の向上を目指してまいります。

<42. (経営基盤の強化) 政策保有株式の縮減目標の導入>

政策保有株式の縮減目標の導入についてご説明します。

当社はこれまでも適宜、政策保有株式の売却を進めており、年1回、全ての個別銘柄について協力関係等の維持の必要性や資本効率性をレビューし、取締役会においてその保有の適否を検証してまいりました。その結果、2017年3月期に37銘柄あった国内上場株式を、現在では17銘柄まで縮減しています。これに加え、当面の方針を明確化するため、2026年3月期までに簿価の5%以上を縮減するという定量的な目標を設定し、2023年4月27日にはコーポレート・ガバナンス報告書の改訂を実施しました。この目標達成に向けて、更なる縮減を推進してまいります。

<43. (経営基盤の強化) コーポレート・ガバナンスに係る取り組み>

コーポレート・ガバナンスに係る取り組みについてご説明します。

1点目は、左側に記載の、株主との価値共有を目的とした業績連動型株式報酬の導入です。今回、取締役賞与の一定金額を超える部分を当社株式で支給することとしました。企業価値向上へのインセンティブを増やし株主様との利害関係を一致させることで、より一層の価値共有を促進してまいります。

2点目は、右側の上段に記載の社外取締役の選任です。今回、新任の社外取締役候補者として、日本新薬株式会社 代表取締役会長の前川 重信氏を選任いたしました。これにより、社外取締役3名の内、企業経営経験者が2名の構成となります。なお、1点目と2点目は、2023年6月の定時株主総会議案として付議される予定です。

右側下段の3点目は、取締役会の実効性向上です。2023年3月期には、今回の中期経営計画立案に当たり、京セラグループ全体の戦略・方針について議論するため、取締役会とは別に2回のオフサイトミーティングを開催しました。当社としては初めての試みでしたが、活発な議論が行われ、その有効性を実感しましたので、今後も事業運営に取り入れてまいります。

<44. (経営基盤の強化) 人材確保に向けた採用戦略>

人材確保に向けた採用戦略についてご説明します。

今後、人材確保面で更なる競争激化が見込まれる中、中期経営計画実現に向けての人材確保が重要となってきます。そのため、先ほどもご説明しました長崎県諫早市の新規立地による人材確保をはじめ、インフレや労働市場を踏まえた給与水準の設定や、海外を含めた生産最適地における採用の拡大、海外の更なる現地化促進などの施策に取り組んでまいります。また、具体的な採用活動の例として、創業者である稲盛和夫の経営哲学に対する社会からの高い関心やオリジナルアニメを使った若年層に対する親しみやすいイメージ訴求など、当社の特長や魅力を多面的に伝えることで理解や興味を深めていただき、人材採用に結び付けていきたいと考えています。

<45. (経営基盤の強化) サステナブル経営の推進>

サステナブル経営推進の具体例として、環境および人的資本等の取り組みについてご説明します。

環境関連では、当社は2020年3月よりTCFDへの賛同を表明しており、温室効果ガス排出量、再生可能エネルギー導入量の具体的な長期環境目標を設定し、2051年3月期にはカーボンニュートラルの実現を目指しています。自社拠点における再生可能エネルギーの導入促進や、高効率設備への更新など、全社一丸となった省エネ推進を図ると同時に、先ほどご説明しました再エネ電力サービスを活用することで、この目標達成を図ります。

次に、ヒトに関する取り組みでは、人権の尊重としてRBAへの加盟や、自社及びサプライヤーに対する人権デュー・ディリジェンスの実施、ハラスメント・差別の禁止教育などを実施しています。また、従業員一人ひとりが生き生きと働ける職場・現場作りを目指し、従業員エンゲージメントの向上や多様性の追求に努めています。右側の下段に一例として、女性管理職数・比率の推移グラフを示しています。当社では女性活躍の推進を行っており、2017年には管理職の内1.5%であった女性比率が2023年には4.8%まで増加しました。2026年にはその比率を8.0%まで増やすべく、キャリア育成プログラムなどに取り組んでいます。

<46. 中期経営計画 まとめ>

こちらは中期経営計画のまとめとなります。

左側に示しています、「コアコンポーネント」、「電子部品」における競争優位分野への戦略的投資、「ソリューション」における既存事業拡大と構造改革の推進、新たな社会課題解決型事業の創出といった事業戦略の実行と、右側に示しています、資本戦略、コーポレート・ガバナンスの取り組み、サステナブル経営の推進といった経営基盤の強化を企業価値向上に向けた戦略の両輪とし、当社中期経営計画の目標を達成するとともに、ROEの持続的向上と、現在1倍を割っておりますPBRの改善につなげてまいります。

以上

将来事象に関する注意事項

当資料には、将来の事象についての2023年3月期通期決算説明会開催日(2023年5月16日開催)時点における当社グループの期待、見積り及び予測に基づく記述が含まれています。これらの将来の事象についての記述には、既知及び未知のリスク、不確実な要因並びにその他の要因が内包されており、当社グループの将来における実際の財政状態及び活動状況が、当該将来の事象についての記述によって明示または黙示されているところと大きく異なる場合があります。詳細は、当社ホームページに掲載の「将来の見通しに関する記述等について」をご参照ください(<https://www.kyocera.co.jp/ir/disclaimer.html>)。